

E-DAT modul REG IP20 unbestückt
E-DAT modul REG IP20 unequipped
E-DAT modul REG IP20 non équipé
1309426103-E

- de Montagehinweis für den Installateur
- en Mounting note for the installer
- fr Notice d'installation pour l'installateur



Passende Module / Suitable modules / Modules appropriés

Ausführung/Version/Version	Art.-Nr./Part No./Référence
E-DATmodul Cat.6 _A 8(8) T568A	130910-I
E-DATmodul Cat.6 _A 8(8) T568B	130910-I-B1
E-DATmodul Kupplung/Coupler/Coupleur 8(8) 180°	1309A0-I
UAEmodul Cat.6 T568A	130909-I
UAEmodul Cat.6 T568B	130909-I-B1
UAEmodul Cat.5e 8(8) T568A	130908-I
UAEmodul Cat.5e 8(8) T568B	130908-I-B1
UAEmodul Cat.6 _A perlweiß / pearl white / blanc perlé	130A11-I
UAEmodul Cat.6 _A schwarz / black / noir	130A11-29-I
OpDAT modul LC-D SM blau / blue / bleu	15091071-I
OpDAT modul LC-D SM APC grün / green / verte	15091076-I
OpDAT modul LC-D MM erikaviolett / heather violett / violett bruyère	15091075-I
OpDAT modul LC-D MM aqua	15091072-I
OpDAT modul LC-D MM beige	15091070-I
OpDAT modul ST SM	15091001-I

HINWEIS / NOTE / NOTICE

de Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

en Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!

fr Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

DEUTSCH

Beschreibung

- Anschlusseinheit unbestückt für ein Einzelmodul mit Modulbauform zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
- die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler
- bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist
- Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden.
- integrierte Staubschutzklappe (auch farblich erhältlich)
- es lassen sich folgende Module einbauen: E-DAT modul, E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D und ST sowie Koax Module
- Achtung: nicht geeignet für C6_Amodul

ENGLISH

Description

- unequipped termination unit for individual module in Modul design for mounting on TH35 rail to DIN EN 60715
- width of 1HP allows mounting up to 12 REG in standard electrical distribution panels
- when mounted as a device of protection class I, the equipotential bonding is realized directly over the top hat rail by means of an integrated equipotential spring. This has to be connected to the equipotential bonding of the building by means of a bonding terminal
- a cover protects the module against direct contact. If mounted in distributor panels with protective insulation, protection class II is guaranteed. In this case, it is necessary to remove the equipotential bonding spring.
- integrated dust protection cover (also colored)
- the following modules can be mounted: E-DAT modul, E-DAT modul coupler 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D and ST as well as Koax modules
- please note: not suitable for C6_Amodul

FRANÇAIS

Description

- Unité de raccordement non équipée pour un module individuel, format : Modul, pour montage sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715
- La largeur utile de 1 UL (unité de division) permet de monter 12 REG au maximum dans des répartiteurs électriques standard
- En cas de montage comme appareil de la classe de protection I, la liaison équipotentielle est effectuée via un ressort de mise à la terre intégré directement sur le rail DIN qui doit être raccordé via des borniers de contact correspondants sur la mise à la terre du bâtiment
- Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II. Dans ce but, il convient d'enlever le ressort de mise à la terre.
- Clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)
- Les modules suivants peuvent être montés : E-DAT modul, coupleur E-DAT modul 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D et ST ainsi que les modules Koax
- Attention : ne convient pas pour C6_Amodul

HINWEIS

Zusätzliche Informationen und weiterführende Dokumentationen wie Datenblatt, stehen zum Download unter www.metz-connect.com für Sie bereit.

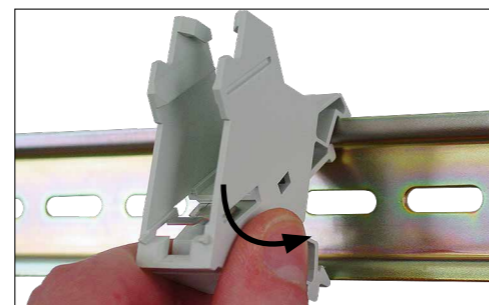
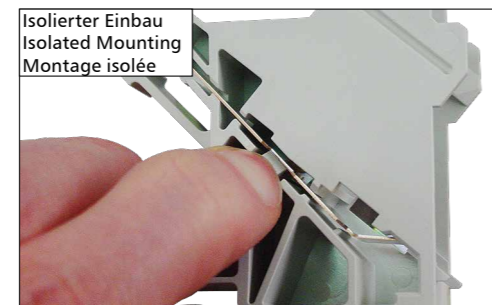
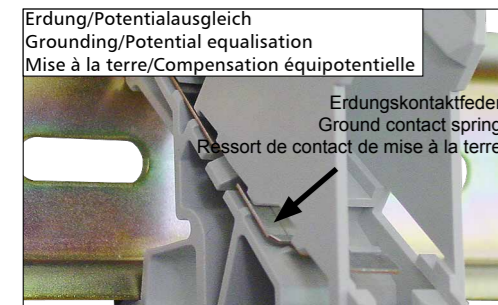
NOTE

More detailed information and documentation such as data sheet are available as download at www.metz-connect.com

NOTICE

Des informations et documentations supplémentaires comme la fiche technique, sont disponibles pour téléchargement sur www.metz-connect.com.

A | Montagevorbereitung / Preparation / Préparation



A | Montagevorbereitung

Die Erdung der Module erfolgt über die Erdungskontaktfeder direkt auf die Montagesschiene. Diese wird durch eine Erdungsklemme mit dem Potentialausgleich verbunden. Montagesschiene muss elektrisch leitend sein. Soll ein Modul nicht geerdet werden, den Rasthaken am Gehäuse nach unten drücken und die Erdungskontaktfeder entnehmen. Anschließend das Gehäuseunterteil auf die Montagesschiene rasten.

A | Preparation

The modules are directly grounded to the mounting rail by the ground contact spring. The rail is connected to earth by a ground clamp. The mounting rail needs to be electrically conductive. Press the mounting latch at the housing downwards and remove the ground contact clamp if a module is to be mounted without grounding. Then click the lower housing part onto the rail.

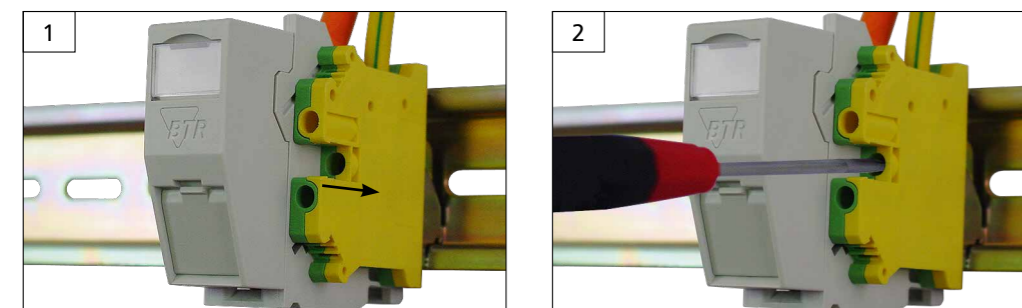
A | Préparation

Les modules sont directement mis à la terre sur le rail par le ressort de contact de mise à la terre. Le rail est raccordé à la compensation équipotentielle par une borne de terre. Le rail doit être électriquement conducteur. Si un module ne doit pas être mis à la terre presser les brides de fixation vers le bas et enlever le ressort de contact. Ensuite encliqueter la partie inférieure sur le rail de montage.

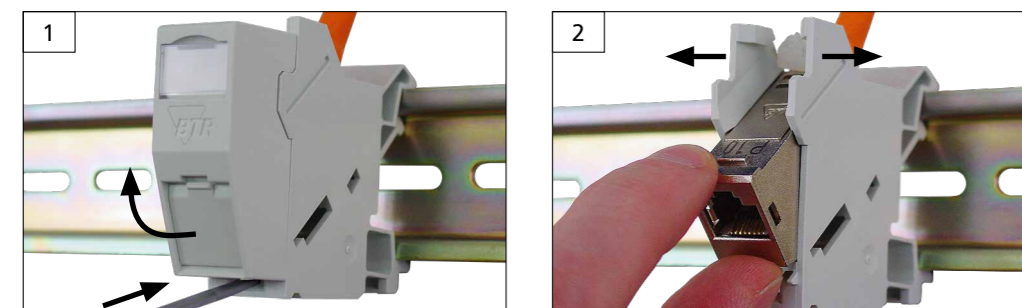
B | Montage der Module / Module installation / Montage de modules



C | Erdung und Potentialausgleich / Grounding and potential equalization / Mise à la terre et compensation de potentiel



D | Demontage / Disassembly / Démontage



de

DEUTSCH

B | Montage des Moduls

Abb. 1: Das fertig angeschlossene Modul in das Gehäuseunterteil einsetzen.

Abb. 2: Gehäuseoberteil oben an das Gehäuseunterteil einhaken und nach unten einrasten.

C | Erdung und Potentialausgleich

Um den Potentialausgleich der Module zu gewährleisten, muss die Montageschiene über eine Erdungsklemme mit dem Potentialerder verbunden werden.

Hierzu diese einfach auf die Montageschiene aufsetzen, festschrauben und am Potentialausgleich anschließen.

D | Demontage

Öffnen des Gehäuses

Gehäuseoberteil mittels eines Schraubendrehers lösen und entfernen.

Entfernen des Moduls

Die Gehäusewände leicht nach außen drücken und das Modul entnehmen.

en

ENGLISH

B | Module installation

Fig. 1: Insert the terminated module into the lower housing part.

Fig. 2: Hook the upper housing part into the top of the lower housing part and click the upper part downwards into place.

C | Grounding and potential equalization

To ensure the potential equalization of the modules, the DIN rail has to be connected to an earth electrode by an earthing clamp.

Clip the earthing clamp on to the DIN rail, fasten the screw and connect it to the potential equalization.

D | Disassembly

Opening the housing

Unclip the upper housing part with a screwdriver and withdraw it.

Remove the module

Press the housing walls slightly outwards and remove the module.

fr

FRANÇAIS

B | Montage du module

Fig. 1: Placer le module raccordé dans la partie inférieure.

Fig. 2: Enclencher la partie supérieure du boîtier en haut de la partie inférieure du boîtier et l'encliqueter vers le bas.

C | Mise à la terre et compensation de potentiel

Pour assurer la compensation de potentiel des modules il faut raccorder le rail DIN au dispositif de mise à la terre du potentiel à l'aide d'une borne de terre.

Enclencher la borne au rail, la visser et la raccorder à la compensation de potentiel.

D | Démontage

Ouvrir le boîtier

Détacher la partie supérieure du boîtier avec un tournevis et l'enlever.

Enlever le module

Ecarter les parois du boîtier légèrement vers l'extérieur et enlever le module.